Umverpackung von Hochtemperatur-Elektronikbaugruppen

Die Grundlagen- und anwendungsorientierten Forschungsarbeiten für die Aufbau- und Verbindungstechnik von Leistungsmodulen und -baugruppen für erhöhte Betriebstemperaturen sind immanenter Bestandteil umfangreicher systemorientierter Untersuchungen zur Einsatzvorbereitung hochintegrierter Logik-Leistungs-Module für z. B. die Energietechnik, die Elektromobilität, die industrielle Antriebstechnik und die Beleuchtungstechnik. Dabei stehen Fragestellungen der Systemintegrationstechnologien für die Steigerung der Leistungsdichte und der Energieeffizienz im Bereich der Leistungselektronik im besonderen Fokus.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt